【新卒可・半導体技術企画】先行技術動向分析・経営層向け技術レポート作成担当

グローバル環境/残業ほぼなし/即入社OK/在留資格サポートあり

Job Information

Hiring Company
iSoftStone

Job ID
1621281

Industry
Electronics, Semiconductor

Company Type
Large Company (more than 300 employees) - International Company

Non-Japanese Ratio
Majority Japanese

Job Type
Permanent Full-time

Location
Kanagawa Prefecture

Salary
5 million yen ~ 8 million yen

Salary Bonuses
Bonuses paid on top of indicated salary.

Work Hours
基本勤務：9:00 ~ 18:00 制度：フレックスタイム制あり

Holidays
土日完全週休二日制、有給休暇、その他日本法定祝日あり

Refreshed
November 3rd, 2026 17:59

General Requirements

Minimum Experience Level
Over 1 year

Career Level
Entry Level

Minimum English Level
Basic Level

Minimum Japanese Level
Business Level

Minimum Education Level
Bachelor's Degree

Visa Status
No permission to work in Japan required

Job Description

・半導体分野における先行技術・新技術動向の調査・分析（論文・特許・学会・業界トレンド等）

・半導体分野における先行技術・新技術動向の調査・分析（論文・特許・学会・業界トレンド等）
・技術的観点から中長期ロードマップの策定、技術テーマ検討の支援
・経営層・技術責任者向け技術分析レポートや提案資料の作成
・社内 R&D 部門・事業部門と連携し、技術課題・開発方向性の整理
・学会・外部パートナーとの技術交流、社内への知見展開。必要に応じ、シミュレーション・技術フィージビリティ検討といった初期検証業務を支援

**職場雰囲気
外資系企業。約 8 割が現地採用の日本人社員。自由度が高く裁量権のある社風。

【必須（MUST）】
・半導体または関連分野での研究開発経験（デバイス / プロセス / 回路 / 材料 / パッケージング等）
・論文・特許などの技術文献を読み解き、自ら技術的考察・判断を実施した経験
・技術テーマを構造的に整理し、意思決定を支援する資料作成・プレゼンテーション経験
・日本語での業務遂行能力、英語技術文献の読解力

【あると望ましい（WANT）】
・下記いずれかの分野に専門性または強い関心をお持ちの方
  -先端パッケージング（2.5D/3D、異種集積、熱対策など）
  -先端材料（低誘電率材料、高熱伝導材料など）
  -プロセッサ / メモリアーキテクチャ（CPU/GPU/NPU 等）
  -AI/ML 関連ハードウェア、画像処理・演算技術
・技術企画、先行研究、技術戦略、産学連携の実務経験
・学会参加、社外技術コミュニティでの活動経験

Company Description